

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2026-040

烟台德邦科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金

存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为 1,487,483,248.88 元。

募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币 135,894,306.56 元后的募集资金为人民币 1,504,132,893.44 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为 535902385410508 的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第 210029 号《验资报告》予以验证。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行
募集资金到账时间	2022 年 9 月 14 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	164,002.72
其中：超募资金金额	84,369.13
减：直接支付发行费用	15,254.4
二、募集资金净额	148,748.32
减：	
以前年度已使用金额	127,333.05
本年度使用金额	5,530.76
暂时补流金额	-
现金管理金额	12,000
银行手续费支出及汇兑损益	0.77
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	5,059.58
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	8,943.32

注：1、上述直接支付发行费用包括主承销商在划入公司账户前已扣除的承销及保荐费，以及以自筹资金预先支付并予以置换的发行费用。

2、以前年度使用金额包括募投项目投入资金、永久补流金额以及利息收入。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金

管理办法》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，明确了各方的权利和义务，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日，公司均严格按照《公司募集资金管理办法》和《募集资金专户存储三（四）方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行	
募集资金到账时间			2022 年 9 月 14 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状态
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410616	652.44	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410266	3,701.18	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410906	-	已注销
烟台德邦科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	12656000000901666	1,860.03	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	中国光大银行烟台经济技术开发区支行	38080188000258467	-	已注销
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410508	38.17	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	中信银行股份有限公司烟台自贸区支行	8110601011601495861	4.65	使用中
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410968	1.43	使用中

烟台德邦科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100862080	9.79	使用中
四川德邦新材料有限公司	中国光大银行股份有限公司烟台九隆支行	38090188000191019	355.41	使用中
四川德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535904836910706	2,211.89	使用中
德邦（昆山）材料有限公司	招商银行股份有限公司昆山支行	512910748910966	-	已注销
德邦（昆山）材料有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	12656000000931613	108.35	使用中
合计	/	/	8,943.32	/

注：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况，详见本报告“募集资金使用情况对照表”（附表1）”

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

本公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间根据实际需要使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品等方式支付募投项目所涉部分款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

报告期内，本公司使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额为23,988,751.29元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2025年9月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不

超过人民币 30,000.00 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

在董事会上述审批范围内，公司在募集资金存放的开户行进行了闲置募集资金现金管理。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行		
募集资金到账时间		2022 年 9 月 14 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000.00	投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）	2025/09/23	2026/09/22	2025/09/23

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行						
募集资金到账时间			2022 年 9 月 14 日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还 金额	预计年化收 益率	利息 金额
烟台德邦科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	招商银行单位大额存单 2026 年第 654 期	大额存单	2,000.00	2026/1/23	2027/1/23	2,000.00	1.40%	28.00
四川德邦新材料有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	智汇区间累积 30D	结构性存款	3,000.00	2026/6/3	2026/7/3	3,000.00	1.0%-1.5%	2.32
烟台德邦科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	人民币单位结构性存款 2610766	结构性存款	7,000.00	2026/6/30	2026/8/5	7000.00	1.00%-1.74%	6.50
合计				12,000.00			12,000.00		36.82

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司于2026年1月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”。新项目实施主体为深圳德邦界面材料有限公司（公司全资子公司，以下简称“深圳德邦”），项目总投资金额23,049.54万元，拟使用原项目剩余募集资金共计6,236.99万元（含理财收益及存款利息，最终金额以实际结余为准）用于新项目。通过新项目的实施，公司有望实现多方面关键效果：一是摆脱租赁场地依赖，提升生产稳定性以及生产效率与质量，为生产优化和研发提供稳定硬件载体；二是支撑产能扩张，助力公司达成营收增长目标；三是承接集团南方基地战略，依托深圳政策与产业优势，对接核心客户、优化供应链并吸引高端人才；四是巩固导热界面材料领域竞争优势，保障订单响应、推动产品升级，巩固国产替代地位并助力细分市场拓展。

新项目投资总额超出募集资金投入部分，将由深圳德邦以自有或自筹资金方式补足。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2026 半年度

编制单位:烟台德邦科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额					148,748.32		本年度投入募集资金总额					5,530.76	
报告期内变更用途的募集资金总额					6,236.99		已累计投入募集资金总额					131,021.97	
变更用途的募集资金总额					11,161.48								
变更用途的募集资金总额比例					7.50%								
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目													
高端电子专用材料生产项目	生产建设	否	38,733.48	38,733.48	38,733.48	0	38,439.15	-294.33	99.24	2023 年 12 月	30,865.03	不适用	否
年产 35 吨半导体电子	生产建设	是	11,166.48	5.00	5.00	0	5.00	0	100.00	已终止	不适用	不适用	是

封装材料建设项目													
德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目	生产建设	是	0	6,236.99	6,236.99	0	0	-6,236.99	0	2028年1月	不适用	不适用	否
新建研发中心建设项目	研发	是	14,479.23	17,690.85	17,690.85	3,795.39	9,799.62	-7,891.23	55.39	2026年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-		64,379.19	62,666.32	62,666.32	3,795.39	48,243.78	-14,422.54	76.99		30,865.03		
超募资金投向													
永久补流	补流还贷	否		53,592.93	53,592.93	0	53,592.93	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
新能源及电子信息封装材料建设项目	生产建设	否		30,776.20	30,776.20	1,735.37	28,890.93	-1,885.27	93.87	2027年2月	9,013.89	不适用	否
超募资金投向小计	-			84,369.13	84,369.13	1,735.37	82,483.86	-1,885.27	97.77		9,013.89		
其他情况													
暂时未确定用途	-	否		1,712.87	1,712.87			-1,712.87	0.00	不适用	不适用	不适用	否
节余募集资金永久补流	-	否				0	294.33	294.33	不适用	不适用	不适用	不适用	否

合计	-		64,379.19	148,748.32	148,748.32	5,530.76	131,021.97	-17,726.35	88.08		39,878.92		
未达到计划进度原因						不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						公司于 2026 年 1 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”。新项目实施主体为深圳德邦界面材料有限公司，项目总投资金额 23,049.54 万元，拟使用原项目剩余募集资金共计 6,236.99 万元（含理财收益及存款利息，最终金额以实际结余为准）用于新项目。新项目投资总额超出募集资金投入部分，将由深圳德邦以自有或自筹资金方式补足。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本专项报告三、（二）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本专项报告三、（四）							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用							
募集资金节余的金额及形成原因						不适用							
募集资金其他使用情况						不适用							

注 1：本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额；

注 2：高端电子专用材料生产项目一期已于 2022 年 8 月达到预定可使用状态，二期已于 2024 年 1 月完成消防验收，达到预定可使用状态；

注 3：年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目调减募集资金投资金额 4,924.49 万元，其中 3,211.62 万元用于新建研发中心建设项目的追加投资，剩余部分 1,712.87 万元及相关利息、理财收益继续留存于募集资金专户；

注 4：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2026 半年度

编制单位: 烟台德邦科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]

未达到计划进度的情况和原因	详见本专项报告三、（八）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。